

103-2 大葉大學 完整版課綱 - 基本資料

基本資訊

課程名稱	半導體原理與製程	科目序號 / 代號	2180 / MSI3027
開課系所	材料科學與工程學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	王偉凱	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(四)567 / H543	授課語言別	中文

課程簡介

課程包括半導體製程相關加工技術之介紹與各種加工原理之說明與應用，使學生熟悉各種加工原理及其應用領域，以作為投入電子工業之基礎訓練課程

課程大綱

第一章 導論
第二章 積體電路製程介紹
第三章 半導體基礎
第四章 晶圓製造
第五章 加熱製程
第六章 微影製程
第七章 電漿製程
第八章 離子佈植製程
第九章 蝕刻製程
第十章 化學氣相沉積與介電質薄膜

基本能力或先修課程

材料分析
半導體原理

